シリコン材料の科学と技術フォーラム 2001 11 月 26 日(月)~ 28 日(水) 湘南国際村センター

主催:シリコン材料の科学と技術フォーラム実行委員会 **共催**:日本学術振興会 結晶加工と評価技術第145委員会

協賛:(社)応用物理学会

実行委員長: 東北大学名誉教授 角野 浩二

実行委員: 富士通研究所 金田 寛 (プログラム委員長)

東北大金研 末澤 正志 岡山大学 上浦 洋一 大阪府立大 井上 直久 MIT 和田 一実

住友金属工業 津屋 英樹 三菱マテリアルシリコン 島貫 康

日立中研 磯前 誠一MEMC 芳賀 博世ワッカーNSCE 原田 博文三菱電機 山本 秀和コマツ電子金属 中村 浩三NEC 北野 友久東芝セラミックス 鹿島 一日児東芝 有働 祐宗

アシスタント: 富士通研究所 高橋 英樹, 棚橋 克人

場 所:湘南国際村センター国際会議場(別紙パンフレット参照)

期日: 平成13年11月26日(月)12:00(受付け開始)~28日(水)15:30

目的:1. 将来のデバイスに見合った高品質シリコン材料の製造,処理技術の効率的な 開発のための基礎研究と応用研究の交流.

2. 当面する問題をブレークスルーするための全員参加の討論.

3. シリコン材料技術が基盤とする種々の学問にかかわる研究者、技術者の再教育.

趣旨:前2回の会合に引き続き,電子デバイス用シリコン材料の高品質化と新技術の展開を図るために、上記の目的を持ったフォーラムを開催します。皆様の積極的なご参加をお待ちします。フォーラムは29の招待講演を基軸としますが,それに加えて、これまでどおり,ポスター発表の論文も募集します。ポスター論文もプロシーディングスに掲載されます。ポスター参加希望の方は下記の要領で論文原稿をお送りください。ポスターセッションとそれに先立つショート・プレゼンテーションのためにも充分時間を取ってあります。また、フォーラム開催期間を通じて充分自由討論を楽しむことができるように,時間的ならびに場所的なアレンジがされています。

ポスター論文の原稿規定: カメラレディの A4 版, 英語, ページ数制限なし, 書式自由の原稿 2 部を 10月10日必着で, 下記の参加申し込み先へお送りください.

参加費 (1人当り) タイプ A: 38,000 円: シングルルームを1人で使用 (消費税含む) タイプ B: 35,000 円: ツインルームを2人で使用 タイプ C: 31,000 円: トリプルルームを3人で使用

参加申込み方法: 別紙「参加申込み書」に、上記 A,B,C の参加タイプを記入の上、下記まで郵便 FAX、

またはEメールでお申し込み下さい、お申込み後、発送します請求書にてお支払い

頂きます.

申込み先 : 〒293-8511 千葉県富津市新富 20-1 新日本製鐵(株)

技術開発本部 TIC 内 (株) 日鉄技術情報センター富津支所 田村紀光 TEL: 0439-80-2073, FAX: 0439-80-2738, E-mail: t-tamura@re.nsc.co.jp

申込み締切り :10月31日:但し,定員(80名)になりしだい締切ります.

問合せ先: 富士通研究所, TEL: 046-250-8232, FAX: 046-248-3473, 046-250-8162

金田 寛(kaneta.hiroshi@jp.fujitsu.com),高橋英樹(takahash@imat.flab.fujitsu.co.jp)

棚橋克人(tanahash@flab.fujitsu.co.jp)